|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec(Korea)** | **SAMS Network**  |
| Ys Kim(김윤선 드림) | Michael Hermen |
| Phone: +82 (10) 2715-6418 | Phone: +49 2405-4526720 |
| ckr-sales@congatec.com<www.congatec.kr> | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

****

**

*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/ko/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/ko/congatec/press-releases.html)

Press release

congatec(콩가텍)이 소개하는 새로운 COM-HPC 에코시스템

**COM-HPC 통합의 중요한 이정표**

**Seoul, Korea, 21 December 2020 \* \* \*** 임베디드 및 엣지 컴퓨팅 기술의 선두 공급업체인 congatec(콩가텍)이 신규 PICMG® COM-HPC™ 표준의 새로운 에코시스템의 기반을 구축하는 최초의 캐리어 보드 및 냉각 솔루션을 소개합니다. 이는 COM-HPC 통합의 주요 이정표로서 최신 11세대 Intel® Core™ 프로세서(코드네임 타이거 레이크)를 기반으로 하는 congatec(콩가텍)의 COM-HPC 모듈 활용을 가속화하기 위해 출시되었습니다. 새로운 COM-HPC 표준은 PCIe Gen 4,USB 4 , 미래형 고속 커넥터 그리고 원격관리를 위한 포괄적인 기능 등 광범위한 최신 고속 인터페이스가 채택되었습니다. 특히 원격 관리 분야는 전용 엣지 디바이스부터 러기드 엣지 클라우드 및 실시간 포그까지 최근 주목받는 광대역 연결 엣지 애플리케이션을 위해 매우 중요합니다.

"congatec(콩가텍)은 COM-HPC 및 COM Express 솔루션으로 최신 Intel 타이거 레이크 프로세서 활용을 위한 두 가지 아주 매력적인 옵션을 제공하게 되었습니다. 시스템 엔지니어 여러분들이 새로운 기능과 이점으로 무장한 새로운 COM-HPC 플랫폼을 테스트해보셨으면 합니다. API가 COM-HPC 및 COM Express에서 100% 일치하므로 엔지니어는 두 플랫폼 모두에서 작업하면서 다른 플랫폼으로 쉽게 서로 전환할 수 있으므로 아주 간편합니다."라고 congatec(콩가텍) 제품 라인 매니저 Andreas Bergbauer는 설명합니다.

11세대 Intel® Core™ 프로세서의 디자인에 COM-HPC를 활용하면 개발자에게 PCIe Gen4 규격 준수 연결성, USB 4.0 전체 대역폭 지원, 2.5 GbE, SoundWire 및 MIPI-CSI 같은 이점을 제공합니다. 고성능 PCIe 또는 최대 25GbE의 이더넷 인터페이스가 필요할 것으로 예상되는 사용자에게도 COM-HPC가 적합합니다. 또한 한 가지 표준만으로 고성능 시스템을 엣지와 포그 서버 성능까지 확장하려는 개발자에게도 COM-HPC가 모든 것을 구현할 수 있는 타당한 근거가 됩니다. 마지막으로 보다 포괄적인 원격 관리 기능을 제공하는 모듈 사용 가능성의 전망 또한 COM-HPC 표준에 대한 새로운 평가 플랫폼을 구매하여 사용할 충분한 이유가 됩니다.

**기능 세트 상세 정보**

평가 목적으로 설계된 ATX 규격의 COM-HPC 용 캐리어 보드 conga-HPC/EVAL-Client 에는 프로그래밍, 펌웨어 플래싱 및 리셋에 요구되는 모든 R&D 인터페이스가 포함됩니다. 또한 새로운 COM-HPC 캐리어 보드는 새로운 COM-HPC Client 표준 규격을 준수하는 모든 인터페이스를 통합하며 -40°C ~ +85°C의 넓은 온도 범위를 지원합니다. 보드는 COM-HPC 사이즈 A, B 및 C를 지원하며 다양한 LAN 데이터 대역폭, 데이터 전송 방법 및 커넥터와 함께 제공됩니다. 이더넷 KR, 최대 2개의 10GbE, 2.5GbE 및 1GbE 지원을 포함한 다양한 버전으로 고객에게 최대한의 유연성을 제공합니다. 보드에는 추가로 최신 고성능 확장 카드를 위한 2개의 고성능 PCIe Gen4 x 16을 지원하는 커넥터가 포함됩니다. 캐리어는 메자닌 카드를 통해 최대 4개의 25GbE 고성능 인터페이스도 실행할 수 있으므로 대규모로 연결된 엣지 디바이스에 완벽하게 맞는 평가 플랫폼입니다.

최신 COM-HPC 모듈용 냉각 솔루션은 3가지 버전으로 출시되었으며 11세대 Intel® Core™ 프로세서의 구성 가능한 12-28W TPD 전 제품군에 적합합니다. 새로운 COM-HPC 모듈은 다음과 같은 프로세서 구성으로 제공됩니다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processor** |  | **Cores/Threads** |  | **Frequency at 28/15/12W TDP, (Max Turbo) [GHz]** |  | **Cache [MB]** | **Graphics Execution Units** |  | **Ext. Temperature range** |
|  | Intel® Core™ i7-1185G7E |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | - |
|  | Intel® Core™ i7-1185GRE |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | yes |
|  | Intel® Core™ i5-1145G7E |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | - |
|  | Intel® Core™ i5-1145GRE |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | yes |
|  | Intel® Core™ i3-1115G4E |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | - |
|  | Intel® Core™ i3-1115GRE |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | yes |
|  | Intel® Celeron® 6305E |  | 2/2 |  | 1.8 (n/a) |  | 4 | 48 |  | yes |

conga-HPC/cTLU의 제품 페이지는 다음과 같습니다.

<https://www.congatec.com/ko/products/com-hpc/conga-hpcctlu/>

COM-HPC 표준 및 전체 에코시스템에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하세요 <https://www.congatec.com/com-hpc>

\* \* \*

**About congatec**

콩가텍은 임베디드 컴퓨팅 제품에 집중하는 굉장히 빠르게 성장하는 기술 집중형 업체입니다. 고성능 컴퓨터 모듈은 산업 자동화, 의료기술, 전송, 통신 및 다양한 어플리케이션과 제품에 사용되며 콩가텍은 글로벌 리더로서 벤처회사부터 글로벌 대기업까지 다양한 고객을 확보하고 있습니다. 2004년에 설립되어 독일 Deggendorf에 본사가 있고 2019년에는 매출 1.26 억불을 달성했습니다. 추가적인 정보는 [www.congatec.com](http://www.congatec.com) 나 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) 그리고 [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).를 참조해 주시기 바랍니다.

*Intel, Celeron and Core are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*